

選修	國際組 學程/領域	應修學分 數18學分	機構原理與設計	3	3	冷凍空調原理	3	3																	
			半導體製程與設備	3	3	專利爭議案例之比較研究	3	3																	
						太陽能工程	3	3																	
						科技論文英語寫作	3	3																	
						微奈米製造與檢測技術	3	3																	
						彈性力學	3	3																	
						機構原理與設計	3	3																	
						奈米結構設計與分析	3	3																	
						對流熱傳學	3	3																	
				電腦輔助設計	3	3	研究方法	3	3	電子設計	3	3	光電工程	3	3										
				高分子材料加工	3	3	機電整合	3	3	電路設計	3	3	微機電系統工程	3	3										
				最佳化設計	3	3	科技管理	3	3	光電元件	3	3													
				製造系統工程	3	3	有限元素法	3	3	配電自動化	3	3													
				產品設計與製造	3	3	系統性創新方法	3	3	機器人學	3	3													
				電腦整合製造	3	3	品質管理	3	3	人工智慧	3	3													
				機電學	3	3	控制系統設計與模擬	3	3	影像處理	3	3													
				逆向工程	3	3	平面顯示器原理與製程	3	3	精密製造	3	3													
				模具設計	3	3																			
				知識管理	3	3																			
				作業管理	3	3																			
			機器學習	3	3																				
			生產系統設計	3	3																				
			微細加工技術	3	3																				
			材料特論	3	3																				
			機構原理與設計	3	3																				
			微機電製程	3	3																				
			精密金屬成型	3	3																				

備註：一、畢業總學分數為 29 學分。

二、必修 11 學分，選修 18 學分。

三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。

四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：

（一）國際組選修科目為全英文上課。

（二）非本系開設之專業選修課程可承認 3 學分。唯修習工學院與電資學院全英文課程，最多承認 9 學分。

（三）經指導教授許可，外籍生得選修工學院內所開設之全英授課課程且無學分限制。